

露笑科技股份有限公司 关于公司碳化硅项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目前期信息披露情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日披露了《关于公司与合肥市长丰县签署建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园战略合作框架协议的公告》，具体内容详见公司 2020-077 号公告。

公司于 2020 年 9 月 16 日披露了《关于公司签署长丰县招商引资投资合作协议的公告》，具体内容详见公司 2020-093 号公告。

公司于 2020 年 10 月 19 日披露了《关于与长丰县签订投资合作协议的进展公告》，具体内容详见公司 2020-098 号公告。

公司于 2021 年 6 月 26 日披露了《关于对合资公司增资的公告》，具体内容详见公司 2021-043 号公告。

公司于 2021 年 11 月 1 日披露了《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》，具体内容详见公司 2021-063 号公告。

二、项目近期进展情况

（一）再次增资

公司于 2021 年 10 月 29 日与长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）、合肥露笑半导体材料有限公司签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定由公司和长丰四面体对合肥露笑半导体增资 20,000 万元人民币，公司认缴新增注册资本 15,000 万元，长丰四面体认缴新增注册资本 5,000 万元。合肥露笑半导体其他 2 名股东合肥北城资本管理有限公司和合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。具体内容详见公司

2021-063 号公告。

（二）项目一期投产

合肥露笑半导体一期已完成主要设备的安装调试，进入正式投产阶段。后续公司会根据市场订单情况及一期投产情况完成产能的进一步扩张。

三、对公司影响

碳化硅项目的建成投产使公司实现国内 6 英寸导电型碳化硅衬底片的突破，配合下游电动汽车、充电桩、光伏新能源等市场的巨大需求，未来将对公司经营业绩产生非常积极的影响。

四、风险提示

目前碳化硅项目进展符合公司预期，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月七日